

用户名 密 码 [注册](#) | [忘记密码?](#) | [FAQ](#)论文快速检索 [高级检索](#)[首页](#)[期刊介绍](#) ▼[编委介绍](#)[投稿须知](#)[读者服务](#) ▼[链接](#)[联系我们](#)[English](#)

金属学报 » 2013, Vol. 49 » Issue (5): 635-640 DOI:

[论文](#)[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)[« 前一篇](#) |

电流密度对直流电解沉积纳米孪晶Cu微观结构的影响

金帅, 潘庆松, 卢磊

中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室, 沈阳 110016

MICROSTRUCTURE DEPENDENCE OF DIRECTCURRENT ELECTRODEPOSITED BULK Cu WITH PREFERENTIAL ORIENTED NANOTWINS ON THE CURRENT DENSITIES

JIN Shuai, PAN Qingsong, LU Lei

Shenyang National Laboratory for Materials Science, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献](#)[相关文章 \(15\)](#)

版权所有 © 2008 《金属学报》编辑部

地址: 沈阳市文化路72号, 中国科学院金属研究所(110016)

电话: +86-024-23971286, 传真: +86-024-23843760 E-mail: jsxb@imr.ac.cn

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn